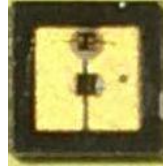


深紫外 LED 产品规格书  
Deep UV LED SPECIFICATIONS

**J35ABA275P06A**

275nm 1in1 LED PKG @ If=40mA



**RoHS**  
compliant

版本: V04

# 目录

1、产品命名规则

2、产品尺寸

3、极限使用条件

4、光电参数

5、输出功率等级

6、光-电特性

**相对光谱分布**

**I - V 特性**

**辐射功率 VS 电流**

**辐射功率 VS 温度**

**正向电压 VS 温度**

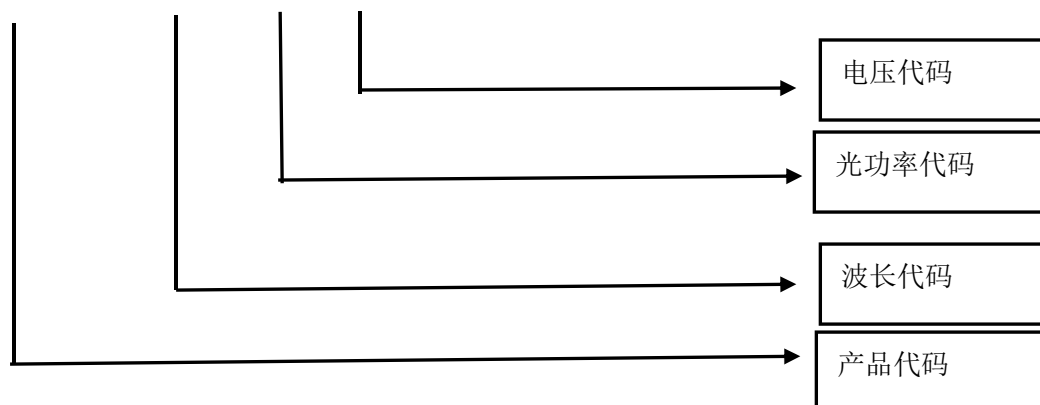
**波峰 VS 温度**

7、典型配光曲线

8、使用说明

## 1、产品命名规则

J 35A B A 275 P06 A



例如: J35ABA275P06A

产品波长: 275nm

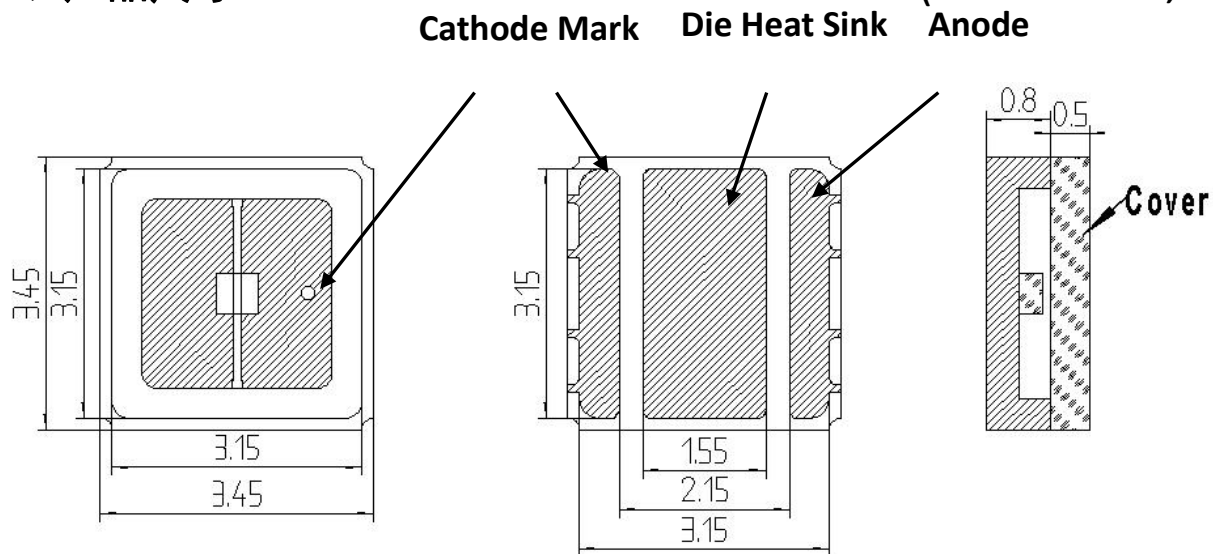
封装类型: 陶瓷 SMD3535

灯珠光功率等级: 3.0-4.0mW

电压档: 5-8V

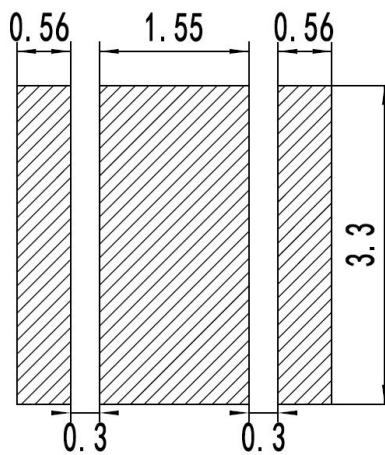
2、产品尺寸

(Tolerance :±0.2, Unit :mm)



建议焊盘尺寸 (回流焊):

如右图, 尺寸单位: mm



### 3、极限使用条件

项目	单位	范围
工作温度	℃	-30~60
存储温度	℃	-30~40
焊接最高温度	℃	170-180

注：将LED置于以上极限范围值以外的条件时，可能会影响器件的可靠性并造成永久损坏。不建议在以上极限范围之外的条件下进行操作。

### 4、光电参数 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

参数	单位	条件	MIN	TYP	MAX
正向电压 ( $V_F$ )	V	$I_F=40\text{mA}$	5	6.5	8
输出功率 ( $P_{out}$ )	mW	$I_F=40\text{mA}$	2	3	5
峰值波长 ( $\lambda_p$ )	nm	$I_F=40\text{mA}$	270	275	285
半波宽 ( $\Delta\lambda$ )	nm	$I_F=40\text{mA}$	9	11	14
发光角度 $2\theta_{1/2}$	deg			120°	
ESD(H.B.M)	V		4000V		

注意：

- 1) 输出光功率  $\pm 10\%$ 。
- 2) 电压的测量公差为  $\pm 0.1\text{ V}$ 。
- 3) 主波长的测量公差为  $\pm 1\text{nm}$ 。
- 4) 均可脉冲工作(频率1 KHZ；占空比：5%)；最大工作电流100mA。

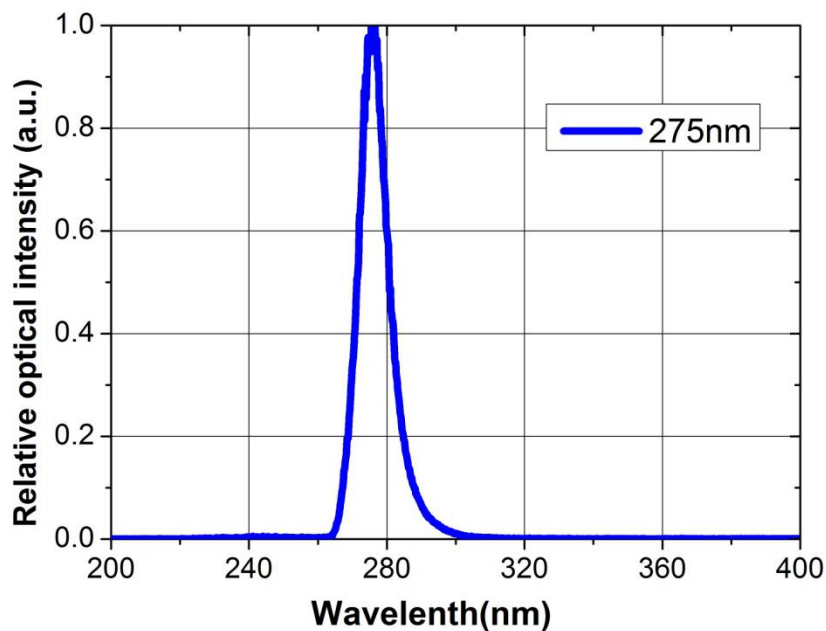
的测量公差为

### 5、输出功率等级

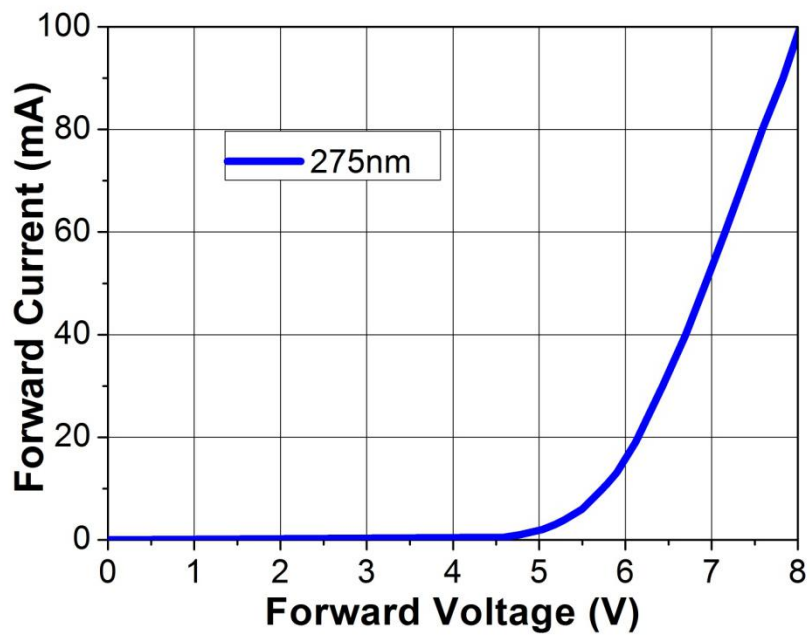
P05	P06	P07
2.0 ~ 3.0mW	3.0 ~ 4.0mW	4.0 ~ 5.0mW

6、光-电特性 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

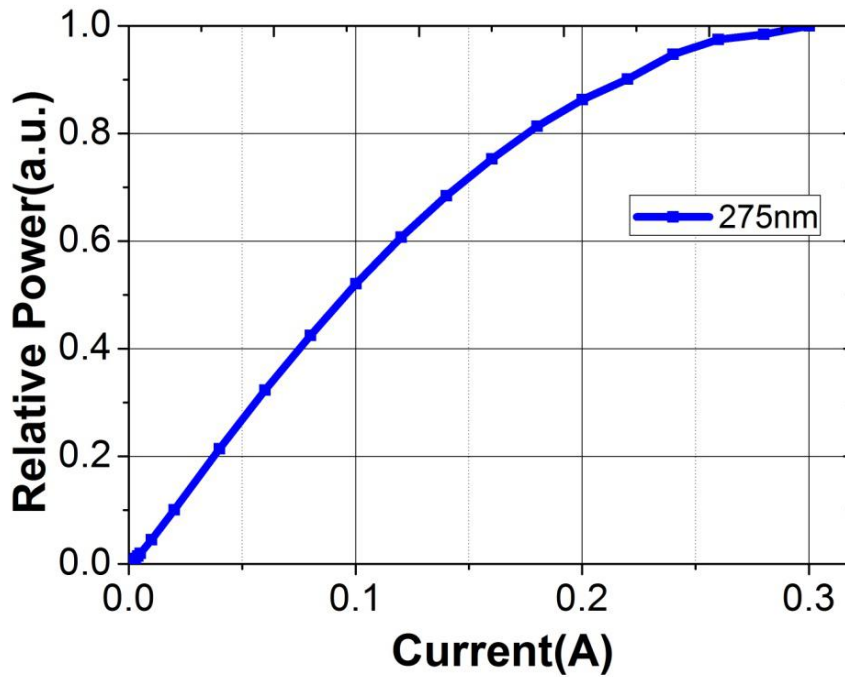
相对光谱分布



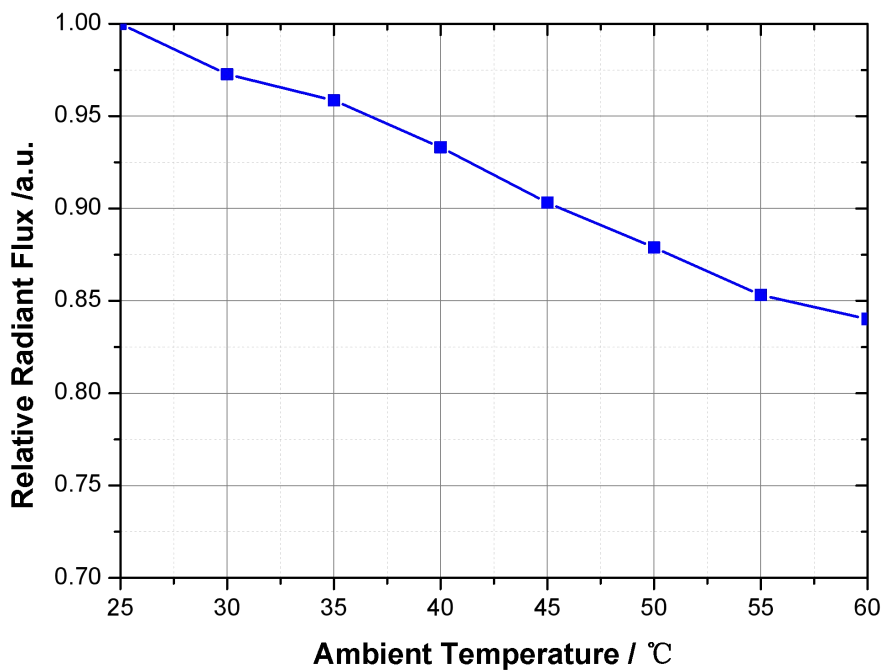
I - V 特性



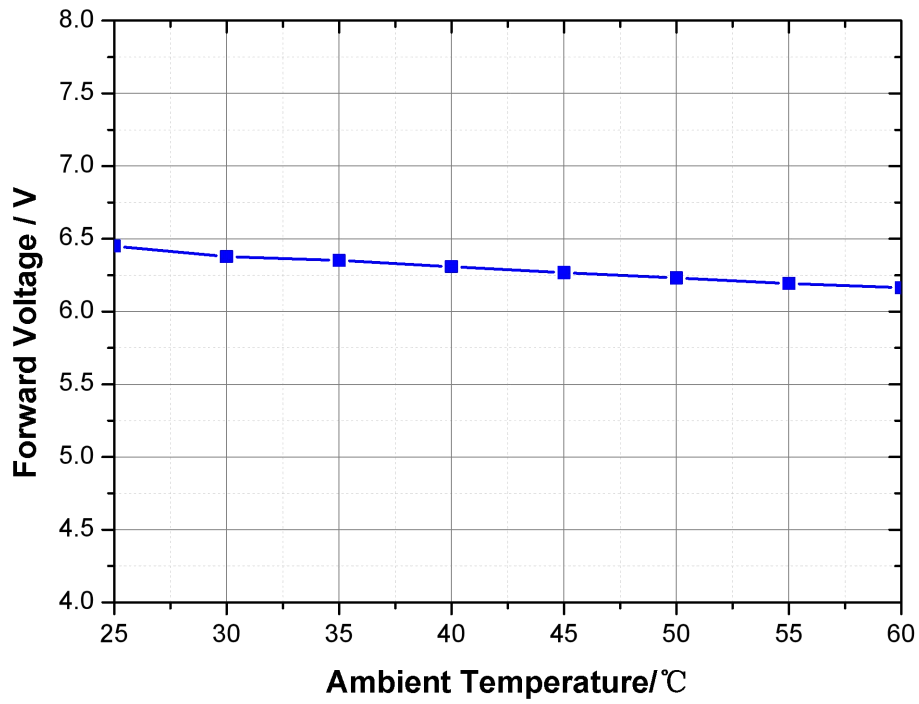
辐射功率 VS 电流



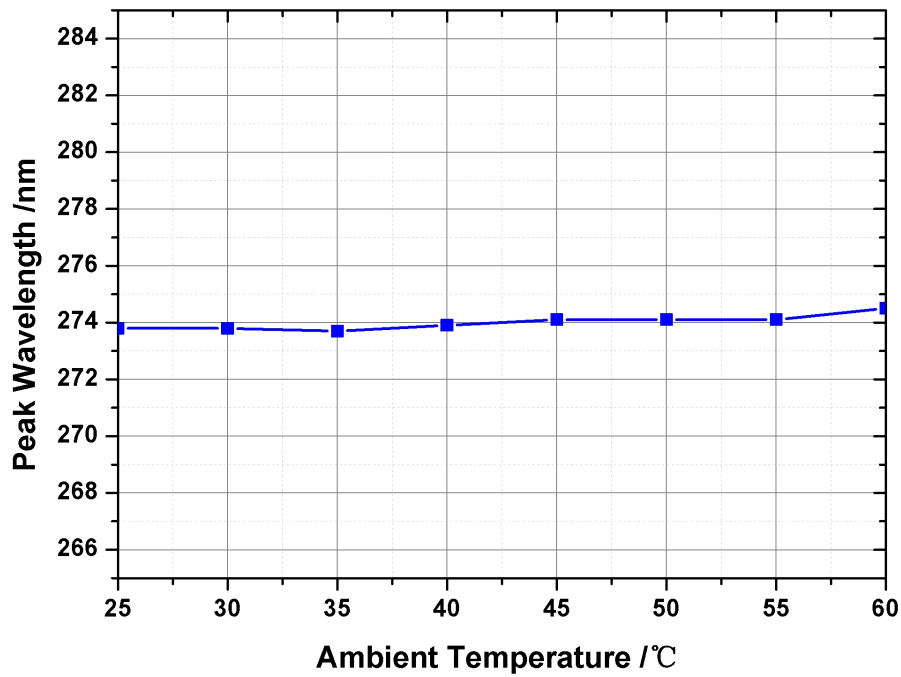
辐射功率 VS 温度 (If=40mA)



正向电压 VS 温度 (If=40mA)

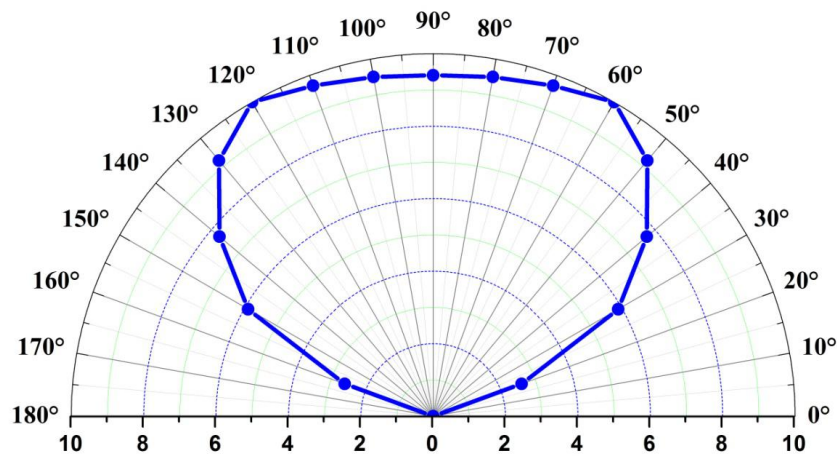


波峰 VS 温度 (If=40mA)





## 7、典型配光曲线



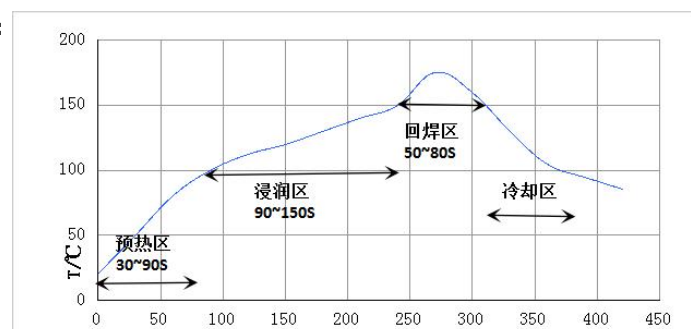
配光曲线 120°（仅供参考）

## 8、使用说明

- 1) LED 贮存：建议存储温度 10°C~30°C，湿度<65%，包装袋密封保存。为了保证产品质量，外包装袋打开前，建议出厂后一年内使用，外包装袋打开后，建议 28 天内使用。
- 2) 拿取方法：接触 LED 检查时需戴手套或手指套，工作台面也要接地，包装袋开口后及时封口，防止引脚氧化。打开包装后，操作人员应该使用镊子夹持 LED 两侧，避免手直接接触 LED 正面。
- 3) 安装：这一过程主要是静电的防护：
  - a. 生产前检点机台设备接地线是否正常。
  - b. 检查人员静电环是否正常，查静电环的金属是否与人的皮肤接触紧密。
  - c. 在安装时最好要求作业员戴好静电手套或静电手指套。
  - d. 作业台面要求铺好静电胶布，胶布之间应互相连接接地。
  - e. 开封后，最好在24小时内用完，否则可能会引起灯脚氧化生锈。
- 4) 建议使用低温锡膏进行回流焊，温度曲线如右所示：

### A. 预热区

升温速率为1.0~3.0°C/s，在预热区的升温速度过快，容易使锡膏的流移性及成分恶化，易产生爆锡和锡珠现象。



**B. 浸润区**

温度110-130°C，时间90-100s最为适宜，

如果温度过低，则在回焊后会有焊锡未熔融的情况发生（建议温升速度 $<2^{\circ}\text{C}/\text{s}$ ）。

**C. 回焊区**

尖峰温度应设定在170-180°C。熔融时间建议把138°C以上时间调整为50-80s。

**D. 冷却区**      冷却速率 $<4^{\circ}\text{C}/\text{s}$

**注：回焊温度曲线乃因芯片组件及基板等的状态和回焊炉的型式而异，建议批量焊接前多做测试，以确保最适当的曲线。**

- 5) LED随着电流的增加和温度的升高，它的使用寿命会呈某种曲线下降，导致LED衰减加快。
- 6) 建议在设计PCB时要有接地电路。特别注意LED使用环境：温度在 $-30^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ 之间，湿度在30%~65%之间，否则将会有静电击穿和大电流击穿导致死灯。
- 7) 产品光电性能级别由我公司自行决定，各不同级别的产品光电性能有所差异，请客户根据己方使用条件自行决定使用方法。
- 8) 我们一直在不断努力，以改善LED产品的性能，规格如有变更，恕不另行通知。

**\*\*重要安全提示：**本产品为深紫外LED，在正确操作通电后会产生深紫外线，这种紫外线对人体的皮肤和眼睛都有危害。应避免未加防护措施直接暴露在深紫外线中。

严禁未加防护措施直接接触紫外线，严禁未戴防护眼镜直视紫外线。

**建议在操作时身穿防护服，佩戴防护手套和防护眼镜。**

